



集成电路设备行业深度报告：集成电路核心要素 当全力发展



区域投资强劲和新型工艺、新型需求驱动，集成电路设备需求逐年增加。全球晶圆厂持续扩张，对设备需求进一步加大，中国大陆地区的需求尤为强烈，2020 年中国大陆地区已成为全球最大集成电路设备市场。集成电路的多层堆栈技术与鳍型栅晶体管技术的广泛应用导致对设备需求进一步加大。

集成电路设备高度垄断，成熟工艺和先进工艺均供不应求。因瓦森纳协议，高端设备对华出口受限。欧美设备供应商因疫情与人力短缺等原因，产能严重不足，同时受美国司法限制，无法在海外设厂扩产。成熟制程所需要的 8 英寸设备更是多年前已陆续停止生产供应。

国产化率上升空间大，国产替代利好国内设备商。国产设备在清洗，刻蚀，薄膜沉积等领域均取得了一定突破。清洗领域国产设备在国内晶圆厂市占率达 20%，且积极开拓海外市场，已获得韩国海力士等国际领先企业订单。刻蚀设备在成熟工艺领域已取得突破，并积极研发高端工艺领域所需设备。薄膜沉积设备方面，在一些新兴特殊工艺赛道，由于起步时间接近，国产设备与国际公司技术差距较小。在光刻领域，荷兰 ASML 垄断全球高端光刻机供应，由于技术壁垒非常高，国内公司仍需不断积累。

业务建议。(招商银行各部如需本部分内容，请参照文末联系方式联系研究院)

关键词: 光刻机 疫情

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35781

